



平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年8月10日

上場会社名 株式会社新川 上場取引所 東  
 コード番号 6274 URL <https://www.shinkawa.com/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 長野 高志  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員 (氏名) 森 琢也 (TEL) 03-5937-6404  
 経営管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成30年8月14日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満四捨五入)

1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	1,865	△36.0	△849	—	△890	—	△939	—
30年3月期第1四半期	2,915	45.1	△412	—	△363	—	△428	—

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 △1,031百万円( —%) 30年3月期第1四半期 △485百万円( —%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第1四半期	△51.67	—
30年3月期第1四半期	△23.55	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第1四半期	25,853	20,513	79.3
30年3月期	24,959	21,545	86.3

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 20,513百万円 30年3月期 21,545百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
31年3月期	—	—	—	—	—
31年3月期(予想)	—	0.00	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成31年3月期の期末配当予想については未定です。

3. 平成31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
第2四半期(累計)	6,300	△12.3	△1,350	—	△1,440	—	△1,530	—
通期	18,900	24.2	△1,270	—	△1,330	—	△1,500	—

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付ページ7「2. 四半期連結財務諸表 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

31年3月期1Q	20,047,500株	30年3月期	20,047,500株
31年3月期1Q	1,874,594株	30年3月期	1,874,404株
31年3月期1Q	18,173,025株	30年3月期1Q	18,173,518株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料の入手方法)

四半期決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(追加情報)	7
(企業結合等関係)	8
3. その他	9
4. 補足情報	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米国・欧州の雇用・所得環境の改善が続き、日本は個人消費の持ち直しの動きがみられ、中国経済では減速の兆しが見られるものの、世界経済は概ね堅調に推移しました。一方で、米国の保護主義的な政策による貿易摩擦の拡大や中東の地政学リスクが高まるなど、景気の下振れリスクが懸念される不透明な状況が続いています。

半導体業界では、データエコノミー時代の到来により、サーバー向けDRAMの需要が急増していることから、DRAMを中心としたメモリが市場を牽引する形で巨額の設備拡張投資が持続しています。また、中国政府は数兆円規模の半導体育成基金を設立し自国の半導体産業を支援していることから、中国メーカーは活発な投資を続けており、半導体製造装置市場の成長が続いています。

当社グループを取り巻く経営環境は、サーバー向けメモリの受注増加、新規引き合いなど旺盛な需要があるものの、スマートフォン市場で、スマートフォンの普及が一巡したことにより、モバイル関連需要が停滞し、設備投資を抑制する動きが見られました。また、当社が注力する先端パッケージでは、ワイヤボンダからフリップチップボンダへと移行が進んでおり、ワイヤボンダの市場はLEDやディスクリット等、少数ピンに移行しつつある状況にあります。

このような環境の下、当社グループは、中期経営計画「Challenge Shinkawa 2020」に基づき、「既存事業の成長」、「新しいビジネス価値の開発」、「組織活性化と人材育成」の3つの基本戦略を軸に、業界のトップグループへの返り咲きを目指して努力してきました。6月には株式会社PFAが新たに当社グループに加わり、新しいグループとしての企業価値向上や、ワイヤボンダの新たなニーズとして電子部品実装にも対応するよう技術強化を進め、市場の拡大を図っています。当社グループは、市場の変化に柔軟に対応すべく、成長市場に絞った製品開発と新規顧客獲得に注力しています。

これらの結果、ダイボンダは前年同期比同水準を維持したものの、ワイヤボンダは前年同期比で減少しました。フリップチップボンダは、YSB55wの車載向け設備投資が好調に推移したことから、前年同期比で増加しました。

当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高1,865百万円（前年同期比36.0%減）、営業損失849百万円（前年同期は営業損失412百万円）、経常損失890百万円（前年同期は経常損失363百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失939百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失428百万円）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より894百万円増加し、25,853百万円となりました。主な増加は、仕掛品1,374百万円および商品及び製品756百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金1,583百万円です。

負債合計は、前連結会計年度末より1,925百万円増加し、5,340百万円となりました。主な増加は、長期借入金800百万円およびその他の流動負債689百万円です。

純資産は、前連結会計年度末より1,031百万円減少し、20,513百万円となりました。主な減少は、利益剰余金939百万円です。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の86.3%から79.3%となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社が事業展開している半導体業界の市場環境と直近の受注状況などを踏まえ、当社グループの業績予想を精査した結果、平成31年3月期の業績見通しを修正しました。詳細につきましては、本日（平成30年8月10日）公表しました「平成31年3月期第2四半期（累計）および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,452	5,467
受取手形及び売掛金	4,971	3,388
電子記録債権	283	374
商品及び製品	2,589	3,345
仕掛品	1,223	2,597
原材料及び貯蔵品	762	890
その他	783	464
貸倒引当金	△1	△3
流動資産合計	17,064	16,522
固定資産		
有形固定資産		
土地	3,217	3,809
その他(純額)	1,796	2,123
有形固定資産合計	5,013	5,932
無形固定資産		
のれん	—	570
その他	43	86
無形固定資産合計	43	656
投資その他の資産		
その他	2,840	2,791
貸倒引当金	—	△49
投資その他の資産合計	2,840	2,743
固定資産合計	7,896	9,331
資産合計	24,959	25,853
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,238	1,637
1年内返済予定の長期借入金	—	200
未払法人税等	72	31
賞与引当金	222	156
製品保証引当金	273	266
その他	379	1,069
流動負債合計	2,185	3,358
固定負債		
長期借入金	—	800
退職給付に係る負債	852	841
その他	378	340
固定負債合計	1,230	1,982
負債合計	3,415	5,340

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	8,360	8,360
資本剰余金	8,907	8,907
利益剰余金	6,289	5,350
自己株式	△3,150	△3,151
株主資本合計	20,406	19,467
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	944	873
為替換算調整勘定	203	180
退職給付に係る調整累計額	△9	△6
その他の包括利益累計額合計	1,139	1,047
純資産合計	21,545	20,513
負債純資産合計	24,959	25,853

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	2,915	1,865
売上原価	1,960	1,315
売上総利益	956	550
販売費及び一般管理費	1,368	1,399
営業損失(△)	△412	△849
営業外収益		
受取利息	3	2
受取配当金	26	18
為替差益	18	—
その他	3	3
営業外収益合計	50	23
営業外費用		
支払利息	1	2
為替差損	—	62
その他	0	0
営業外費用合計	1	65
経常損失(△)	△363	△890
特別損失		
固定資産除却損	—	2
特別損失合計	—	2
税金等調整前四半期純損失(△)	△363	△892
法人税、住民税及び事業税	23	8
法人税等調整額	43	39
法人税等合計	65	47
四半期純損失(△)	△428	△939
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△428	△939

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
四半期純損失(△)	△428	△939
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△48	△72
為替換算調整勘定	△6	△23
退職給付に係る調整額	△3	2
その他の包括利益合計	△57	△92
四半期包括利益	△485	△1,031
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△485	△1,031
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—



(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当第1四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した株式会社パイオニアFA(現 株式会社PFA)を連結の範囲に含めています。

なお、みなし取得日を平成30年6月30日にしているため、貸借対照表のみを連結し、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に被取得企業の業績は含まれていません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

在外連結子会社の税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

なお、在外連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。

## (企業結合等関係)

## (取得による企業結合)

## (1) 企業結合の概要

## ① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社パイオニアFA

事業の内容 電子部品の実装装置、組立装置、検査装置等の設計、製造、販売および  
各種製造用ソフトウェアの開発、販売

## ② 企業結合を行った主な理由

株式会社パイオニアFAは、スマートフォンや自動車用の電子部品の実装機や検査装置、生産技術のソリューションを提供しています。同社が持つ高い技術力と柔軟性、生産ラインでのトータルソリューション提供力と、当社グループが持つ半導体ボンディング分野での高速・高精度の実装技術力を共に活用することで、半導体ボンディングの前後の工程を一貫したソリューションとして提供することや、電子部品分野の実装技術の競争力をより高めることが相互に可能になり、両社においてシナジー効果が見込まれ、当社グループの企業価値向上に寄与するものと判断しました。

## ③ 企業結合日

平成30年6月1日

## ④ 企業結合の法的形式

株式取得

## ⑤ 結合後企業の名称

株式会社PFA

## ⑥ 取得した議決権比率

100%

## ⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として、株式取得により議決権比率の100%を獲得したことによります。

## (2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

みなし取得日を平成30年6月30日としているため、被取得企業の業績は、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれていません。

## (3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得対価	現金	2,069百万円
取得原価		2,069百万円

## (4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザーに対する報酬・手数料等 30百万円

## (5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

## ① 発生したのれんの金額

570百万円

## ② 発生原因

被取得企業の時価純資産が取得原価を下回ったため、当該差額をのれんとして認識したことによります。

## ③ 償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

### 3. その他

#### 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、製品の開発および評価期間の長期化や売上高に対して固定費の比重が高いことなどから、過年度に連続して営業損失、経常損失および親会社株主に帰属する当期純損失を計上していました。前連結会計年度では、特別利益として投資有価証券売却益が生じたことにより、親会社株主に帰属する当期純利益を計上したものの、営業損失および経常損失を計上しています。このような状況により、当社は継続企業の前提に関する重要事象等が存在しています。

当社グループは、当該状況を解消すべく、中期経営計画「Challenge Shinkawa 2020」を策定し、以下の施策に取り組んでいます。

#### ①既存事業の成長

IoT時代の到来を受け、半導体パッケージへの要求には様々な変化が見られます。データストレージのSSD化やメモリの高速化に対応すべく、引き続きワイヤボンダ、ダイボンダの機能強化を進めるとともに、メモリキューブや先端CPUに使われる3次元/2.5次元実装に向け、Thermal Compression Bondingなどの最先端実装工法に対応したフリップチップボンダの開発および拡販を推進します。

また、スマートフォンなどの通信機器の高機能化にともない、PoP (Package on Package) やFO-WLP (Fan Out-Wafer Level Package) などの高機能パッケージの需要が拡大しつつあり、これらに対応したフリップチップボンダの機能強化も進めています。

#### ②新しいビジネス価値の開発

Shinkawa Smart Bonding Solutionのコンセプトのもと、半導体組立工程にIoT機能を取り込んだソリューションの開発を進めています。装置のインテリジェント化（センシング機能の強化）、ネットワークのインテリジェント化（データ収集・解析機能の強化）、プロセスのインテリジェント化（ノウハウのソフト化）を推進し、IoT社会の進展に伴って発生する課題に先んじてソリューションを提案することで、顧客満足と企業価値の向上を図ります。

#### ③組織活性化と人材育成

創造性を発揮する組織へと変革するため、多様な人材の確保が必要となります。世界各国の優秀な人材が活躍するステージを提供するとともに、意識改革をはじめとした人材育成に注力しています。

また、当社グループの自己資本比率は79.3%であり、当連結会計年度の事業運営を進めるための資金については取引銀行と当座貸越契約を締結し、十分に確保しています。

以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しています。

## 4. 補足情報

## 最近における四半期毎の業績の推移

平成30年3月期(連結)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
	平成29年4月 ～平成29年6月	平成29年7月 ～平成29年9月	平成29年10月 ～平成29年12月	平成30年1月 ～平成30年3月	平成29年4月 ～平成30年3月
売上高(百万円)	2,915	4,272	3,321	4,706	15,214
売上総利益(百万円)	956	1,450	1,095	1,220	4,722
営業利益又は営業損失(△) (百万円)	△412	90	△209	△89	△620
経常利益又は経常損失(△) (百万円)	△363	171	△157	△140	△488
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)(百万円)	△363	171	△157	968	619
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)	△428	172	△169	988	563
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)	△23.55	9.48	△9.28	54.34	31.00
総資産(百万円)	24,893	25,114	25,750	24,959	24,959
純資産(百万円)	21,094	21,567	21,806	21,545	21,545
受注高(百万円)	3,136	3,107	3,342	5,005	14,589

平成31年3月期(連結)

	第1四半期
	平成30年4月 ～平成30年6月
売上高(百万円)	1,865
売上総利益(百万円)	550
営業損失(△)(百万円)	△849
経常損失(△)(百万円)	△890
税金等調整前四半期純損失(△)(百万円)	△892
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)	△939
1株当たり四半期純損失(△)(円)	△51.67
総資産(百万円)	25,853
純資産(百万円)	20,513
受注高(百万円)	2,552